

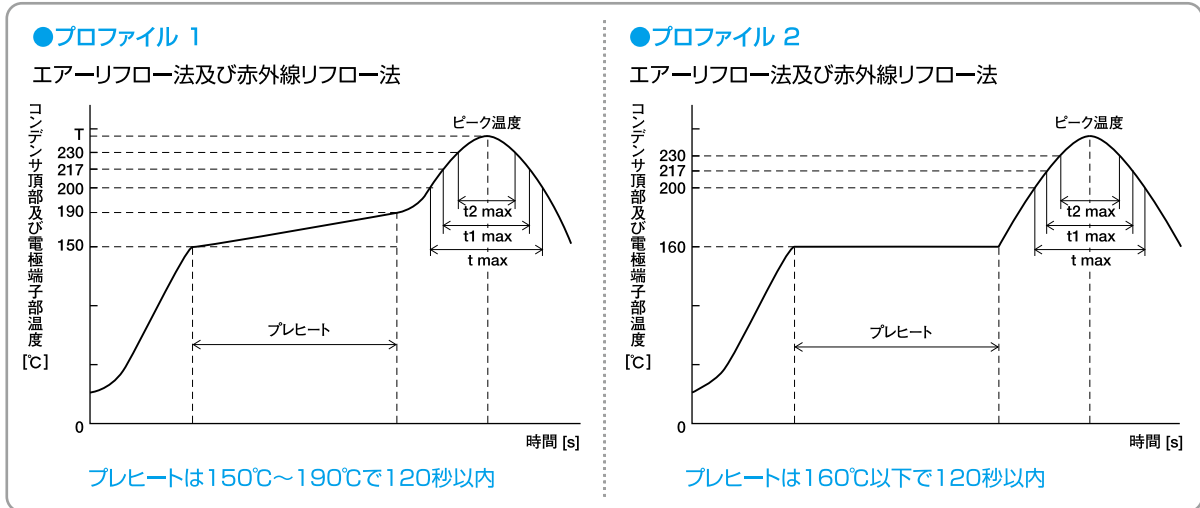
はんだ付け条件・リフロー許容条件・リップル電流周波数補正係数

導電性高分子ハイブリッド
アルミニウム電解コンデンサ

■はんだ付け条件

- 手はんだの場合、特に規定の無い限り、350℃、3秒以下にて使用してください。
- フローはんだの場合、特に規定の無い限り、260℃、10秒以下にて使用してください。(面実装形には適用しないでください。)
- 熱硬化炉等を通す場合は、150℃以下の雰囲気中で2分以内としてください。

■面実装形リフロー許容条件



シリーズ名	電圧範囲 (V)	対象サイズ	200℃以上での滞留時間 (t)	217℃以上での滞留時間 (t1)	230℃以上での滞留時間 (t2)	ピーク温度 (T)	回数	プロファイル
HVA, HVBF	6.3~16	全サイズ	100秒以内	80秒以内	40秒以内	250℃(5秒以内)	2	1
HVH, HVP, HVT	16~63	全サイズ	100秒以内	80秒以内	40秒以内	260℃(5秒以内)	2	1
HVHZ, HVPZ	80~125	全サイズ	100秒以内	80秒以内	40秒以内	250℃(5秒以内)	2	1
HVHF, HVPF	25~50	φ6.3	70秒以内	40秒以内	30秒以内	260℃以下	2	2
		φ8~φ10	70秒以内	40秒以内	30秒以内	260℃以下	1	2
	63~80	全サイズ	70秒以内	40秒以内	30秒以内	245℃以下	2	2

上記の条件で2回リフローが可能なシリーズは、2回目を行う場合、1時間以上自然放冷し、基板および部品が常温に復帰後行ってください。

■リップル電流周波数補正係数

シリーズ名	定格静電容量 C (μF)	周波数:F (Hz)			
		100 ≤ F < 1k	1k ≤ F < 10k	10k ≤ F < 100k	100k ≤ F < 500k
HVH, HVP, HVT HVHZ, HVPZ HVHF, HVPF	C ≤ 4.7	0.03	0.30	0.65	1.00
	4.7 < C ≤ 33	0.05	0.32	0.67	1.00
	33 < C	0.10	0.35	0.70	1.00
HVA, HVBF HEA, HEBF	C ≤ 10	0.03	0.20	0.50	1.00
	10 < C	0.05	0.20	0.50	1.00

■耐振動構造

ケースサイズφ8、φ10は耐振動構造対応可能です。
[品番の形状記号]

一般品	耐振動構造品
HV	HA